

HPSP403870

될놈될

공정 미세화에 따른 동사 장비의 구조적 성장 기대

동사는 고압 수소 어닐링 장비를 글로벌 독점으로 생산 및 공급하고 있다. 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 16nm 이하 미세공정과 HKMG 구조 하에서 저온으로 반도체 계면 결함을 치유할 수 있는 유일한 솔루션이다. 동사 매출비중의 70%를 차지하는 비메모리 시장에서의 미세공정 확대 트렌드에 이어 2025년 DRAM 1c, 300단 이상 NAND등 메모리의 공정 미세화 역시 지속됨에 따라 동사 장비 채용 확대가 이어질 것이다. DRAM 1c 공정에서는 동사 장비가 필수적이며 NAND 역시 단수 증가에 따른 계면 결함이 증가한다.

메모리 적용 확대 + Capa 확장 + 신장비 납품

현재 동사의 주요 투자포인트는 세 가지로 정리해볼 수 있다. 1) DRAM과 NAND 모두 신규 고객사향 고압 수소 어닐링 장비 테스트가 진행중으로 연내 메모리 고객사 확장 기대된다. 2) 현재 Capa를 2022년 말 대비 2배 수준으로 증설 중으로 2025년부터 매출액 기준 3,200억원 이상 Capa가 온기로 반영될 전망이다. 3) 파운드리 Top-tier 고객사향으로 신규로 고압 습식 산화막 장비 데모 테스트 진행중으로 상반기 중 쉘 테스트 완료 및 하반기 중 납품을 기대한다.

투자의견 매수, 목표주가 58,000원 제시

HPSP의 독자적인 기술력과 2024년 포트폴리오 확장 모멘텀에 따라 투자의견 매수, 목표주가 58,000원으로 커버리지를 개시한다. 2024년 매출액 2,164억원(+21% YoY), 영업이익 1,182억원(+20% YoY, OPM 55%)을 전망하며 목표주가는 2025F 추정 EPS 1,812원에 Target P/E 32배를 적용하여 산출하였다. 세트 수요는 여전히 불확실한 와중 AI 산업에서의 메모리 수요는 지속적으로 증가하고 있다. 2024년에도 메모리 업체들이 고성능 DRAM 양산 확대에 집중하는 전략이 이어질 것으로 전망한다. 이에 따라 중소형주에서도 선단공정 확대에 따른 수혜가 확실한 장비 업체에 대한 선별적인 접근이 필요하다는 판단이다. 불확실한 대외 환경에도 불구하고 메모리 고객사들의 선별적인 Capex 증가(1a, 1b 전환 및 HBM Capa 증설)로 인해 동사 경쟁력은 더욱 부각될 것이다.

Financial Data

(억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	918	1,593	1,787	2,164	3,300
영업이익	452	852	981	1,182	1,798
영업이익률(%)	49.3	53.5	54.9	54.6	54.5
세전이익	467	869	1,112	1,297	1,914
지배주주지분순이익	353	660	859	996	1,470
EPS(원)	529	813	1,058	1,228	1,812
증감률(%)	67.5	53.8	30.1	16.0	47.6
ROE(%)	81.4	53.2	36.3	30.5	32.9
PER(배)	n/a	16.4	44.0	38.0	25.7
PBR(배)	n/a	1.4	13.6	10.1	7.3
EV/EBITDA(배)	-1.1	10.4	35.9	28.4	18.3

자료: HPSP, DS투자증권 리서치센터, K-IFRS 연결기준

이수림 반도체
02-709-2661
surim.lee@ds-sec.co.kr

2024.01.31

매수(신규)

목표주가(신규)	58,000원
현재주가(01/30)	46,600원
상승여력	24.5%

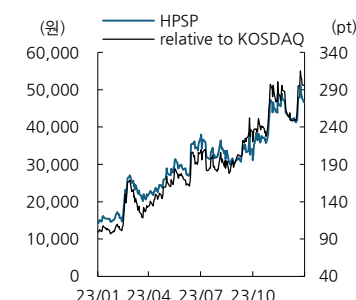
Stock Data

KOSDAQ	818.9pt
시가총액(보통주)	3,861십억원
발행주식수	82,844천주
액면가	500원
자본금	406십억원
60일 평균거래량	2,192천주
60일 평균거래대금	95,335백만원
외국인 지분율	23.1%
52주 최고가	70,500원
52주 최저가	16,000원
주요주주	
프레스토제6호사모투자합회사 (외 1인)	39.6%
한미반도체(외 2인)	12.1%

주가추이 및 상대강도

(%)	절대수익률	상대수익률
1M	6.3	11.8
3M	36.9	28.7
6M	29.8	40.2

주가차트



기업개요

High-K Metal Gate 적용 시 꼭 필요한 장비 업체

공정 미세화에 따른 동사 장비의 구조적 성장 기대

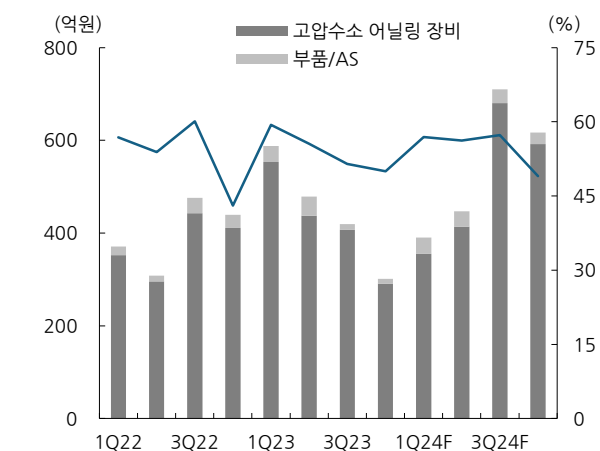
고압 수소 어닐링 장비
글로벌 독점 업체

HPSP는 2017년 설립되어 2022년에 코스닥 시장에 상장한 반도체 전공정 장비업체이다. 글로벌 독점으로 반도체 전공정에 사용되는 고압 수소 어닐링 장비를 글로벌 반도체 Top-tier 업체 향으로 생산 및 판매하고 있다. 매출비중은 3Q23 누적 기준 비메모리향 70% 이상, 메모리향 30% 이하 수준으로 형성되어있다. 2022년 상장 당시 글로벌 독점 기술력과 영업이익률 50%에 달하는 이익체력으로 시장의 주목을 한 몸에 받은 바 있다.

고압 수소 어닐링 장비는
HKMG 구조 하 계면 결함
치유에 필수적

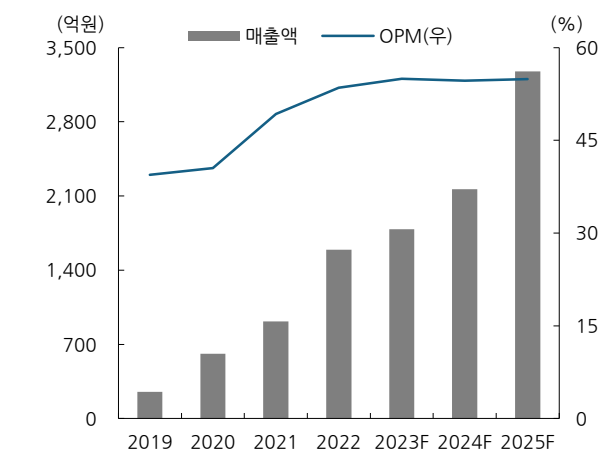
고압수소 어닐링 장비(HPA)는 반도체 웨이퍼와 절연막 사이 계면에 발생하는 '계면 결함(Interface Defect)'을 치유하기 위해 사용된다. 계면 결함이란 주로 전공정 중 이온 주입 공정으로 인해 웨이퍼 계면에 빈 공간이 발생하는 문제 현상을 의미한다. 기존에는 AMAT, TEL, Kokusai 등 업체의 고온 어닐링(600~1,100도)을 통해서 결함을 치유했으나 반도체 공정 미세화로 High-K Metal Gate(이하 HKMG) 구조로 진화하면서 고온에서 Metal이 녹는 문제로 인해 고온 어닐링 장비를 사용할 수 없게 되었다. 이때 저온(250~450도)에서 100% 농도의 수소를 고압으로 어닐링하는데 성공한 동사의 장비가 시장의 주목을 받게 되었다. 동사의 고압 수소 어닐링 장비는 2nm 수준의 미세공정까지 적용이 가능하며 폭발성이 강한 고압 수소에 대한 기술 진입장벽으로 글로벌 독점 지위를 유지하고 있다.

그림1 HPSP 분기별 실적 추이 및 전망



자료: HPSP, DS투자증권 리서치센터

그림2 HPSP 연간 실적 추이 및 전망



자료: HPSP, DS투자증권 리서치센터

투자포인트

1) HPA 장비 적용처 확대 전망

DRAM과 NAND

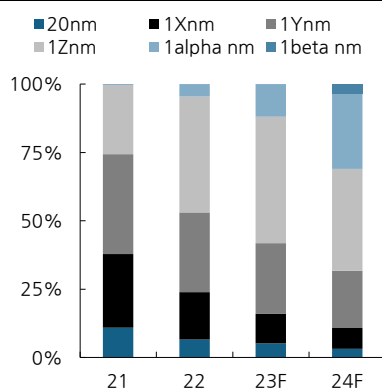
신규 고객사향 장비 테스트
진행중

메모리: 동사는 기존 메모리 향으로 DRAM 1개, NAND 2개 고객사를 보유중이며 현재 DRAM과 NAND 모두 신규 고객사향 장비 테스트가 진행중이다. 주요 메모리 고객사는 2025년부터 DRAM 1c 개발 및 양산화 예정이며 NAND 역시 적층단수가 300단 이상(Triple Stacking)으로 확대할 계획으로 2H24 내로 적용처 확대가 기대된다. 동사 장비는 적용처마다 상이하기는 하나 대략 Wafer Capa 10K 당 1.5대 정도가 요구된다.

공정 미세화 트렌드가 지속
됨에 따라 동사 장비 채용
확대로 이어질 것

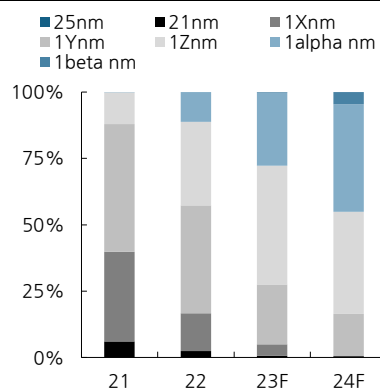
2024년은 메모리 시장에서 1a, 1b 최선단공정 비중이 합산 45% 수준(SK하이닉스 기준)까지 확대되는 원년이다. 2025년 DRAM 1c, 300단 이상 NAND 등 공정 미세화 트렌드가 지속됨에 따라 동사 장비 채용 확대에 이어질 것이다. DRAM에서는 공정 미세화에 따라 HKMG 구조의 적용이 점차 확대되며 1c 공정에서는 동사 장비가 필수적이다. 미세화의 난이도 상승으로 전공정에서의 한계가 대두되지만 여전히 선단공정 기술은 생산성 및 성능 향상을 위해 매우 중요하며 언제나 기술 혁신을 추구해야 하는 반도체 업체들은 1b, 1c 이상 최선단공정에 대한 전환투자를 지속할 것으로 전망한다.

그림3 삼성전자 공정 노드별 생산비중



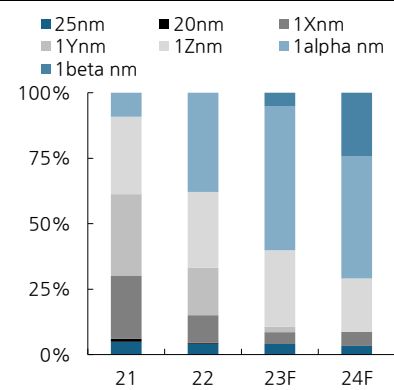
자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림4 SK하이닉스 공정 노드별 생산비중



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림5 Micron 공정 노드별 생산비중



자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

비메모리 고객사 선단공정에 대한 투자 집중

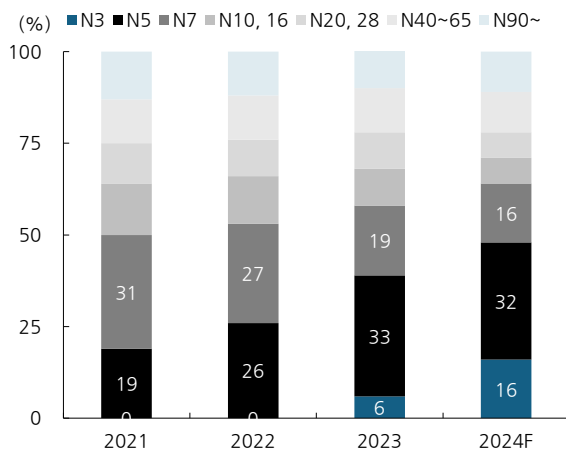
비메모리: 동사의 비메모리향 매출비중은 약 70% 이상으로 현재 비메모리 고객사들은 7nm 미만 초미세공정에 대한 공격적인 투자를 집행하고 있다. 로직/파운드리 등 비메모리 고객사들은 2024년에도 전년대비 Capex 감축을 계획하고 있지 않으며 특히 선단공정에 대한 투자를 더욱 집중할 전망이다. 대표적으로 TSMC는 2024년 예상 Capex로 USD 기준 280억~320억 달러를 제시했다. 이는 2023년과 유사한 수준의 Capex 집행이며 (2023년 Capex 304.5억 달러) 이 중 70~80%는 선단 공정에 집행될 예정이다. 또한 2025년 2나노 공정의 도입을 목표로 하고 있다.

GAA-FET으로 진화하며 동사 장비 수요 동반 성장

또한 비메모리에서도 트랜지스터 구조가 Fin-FET에서 GAA-FET으로 진화하며 노출 면적이 커짐에 따라 계면 결함 역시 증가하게 된다. 또한 공정이 미세화될수록 공정 시간 자체도 증가하며 동사 장비에 대한 수요 역시 동반 성장하게 된다.

Appendix) 최근 공정 미세화로 실리콘 산화막의 누설 전류 문제가 심화되어 실리콘 대비 유전율(K)이 높은 High-K 소재로 누설 전류를 차단하고 더 얇은 두께의 트랜지스터를 구현하는 HKMG(High-K Metal Gate)의 채택이 증가하고 있다.

그림6 TSMC 공정별 매출비중 및 전망



자료: TSMC, DS투자증권 리서치센터

그림7 2023~2027 메모리 신규 Fab 예정

New Fabs	DRAM	NAND
2023	<ul style="list-style-type: none"> • SEC P3 • CXMT HF2 	-
2024F	-	<ul style="list-style-type: none"> • Kioxia JV K2
2025F~2027F	<ul style="list-style-type: none"> • SEC P4 • SKH 용인 클러스터 • MU Boise, NY, NTC(Fab3B) 	<ul style="list-style-type: none"> • SEC P3, P4 • SKH M15X, 청주

자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

2) 2025년 Capa 2배 온기로 반영

2024년 상반기 중 신공장 램프업 마무리, 하반기부터 Capa 2배 온기 반영

2023년 말 기준 동사 Capa는 장비 대수 기준으로 연간 약 40대 생산이 가능한 수준이다. 현재 동탄 신공장 증설 중으로 2024년 상반기 중 신공장 램프업 마무리되고 하반기부터 양산 가능한 Capa는 약 2배(장비 기준 80대) 수준으로 증가할 전망이다. 2025년부터 매출액 기준 3,200억원 이상 Capa가 온기로 반영될 전망이다. 기존 2022년 가동률 100%, 2023년 가동률 90% 중반 수준이었으나 Capa 증설로 매출규모 성장의 기반이 마련되었다는 판단이다.

3) 비메모리 고객사 향 고압 습식 산화막 장비(HPO) 신규 납품 기대

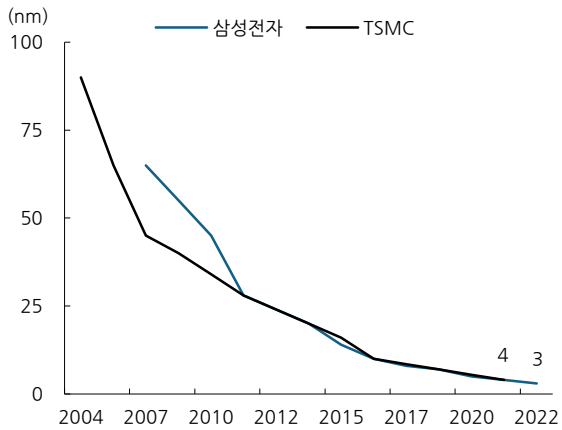
파운드리 Top-tier 고객사 향 켈테스트 상반기 완료 기대

파운드리 Top-tier 고객사향으로 켈테스트가 진행중인 고압 습식 산화막 장비(HPO)는 저온 고압 환경에서 산화막을 형성하는 장비로 역시 HKMG 구조에서 고온 공정 적용 시 Metal이 녹는 문제를 해결하기 위해 도입된다. 3nm 이하 초미세공정에 적용될 것으로 전망한다. 초기 계획 대비 지연되기는 했으나 주요 고객사 향으로 데모 테스트를 진행중인 상황으로 상반기 중 켈 테스트 완료를 기대한다.

산화공정은 공정 진행 시 발생하는 불순물로부터 웨이퍼를 보호하고 누설 전류를 차단하는 절연막을 만드는 공정이다. 특히 배선이 합선되지 않도록 하는 절연막의 역할이 중요하여 반도체 제조공정에서 수차례 적용된다. 산화막은 800도 이상의 고온에서 산소나 수증기를 웨이퍼 표면에 뿌려 얇고 균일한 실리콘 산화막을 형성한다. 하지만 역시나 HKMG 구조 하에서는 고온 공정 적용 시 Metal이 녹는 문제가 발생하게 된다. 따라서 증착 공정인 CVD를 사용하여 실리콘 산화막을 형성하는데, 가스의 화학적 반응을 이용하는 CVD는 불순물 함유량이 높아지고 손상이 유발되는 등 산화막의 품질을 떨어뜨리는 문제가 발생한다.

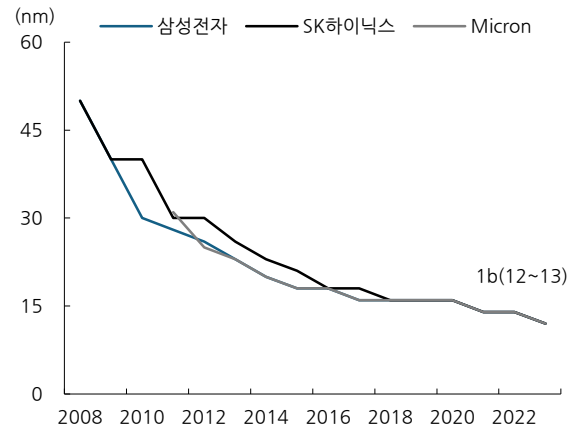
선단공정에서는 균일한 산화막이 형성되는 것이 수율에 굉장히 중요하고 이에 따라 저온 고압으로 고품질의 균일한 산화막을 만들어 낼 수 있는 동사의 HPO 장비가 대안이 될 가능성이 높다. 동사의 HPO 장비는 압력을 높여서 저온에서도 산화속도가 증가할 수 있도록 작용한다.

그림8 파운드리 공정 미세화



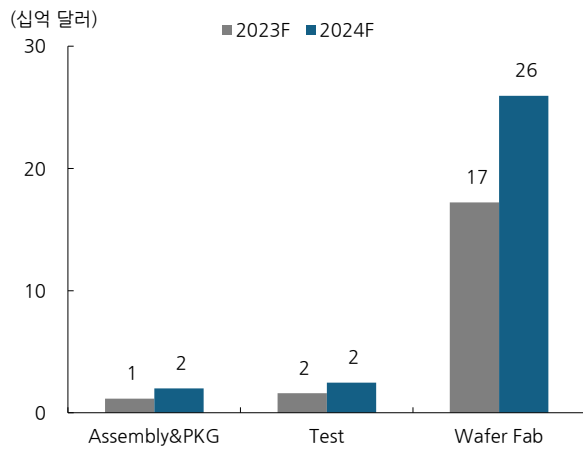
자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림9 DRAM 공정 미세화



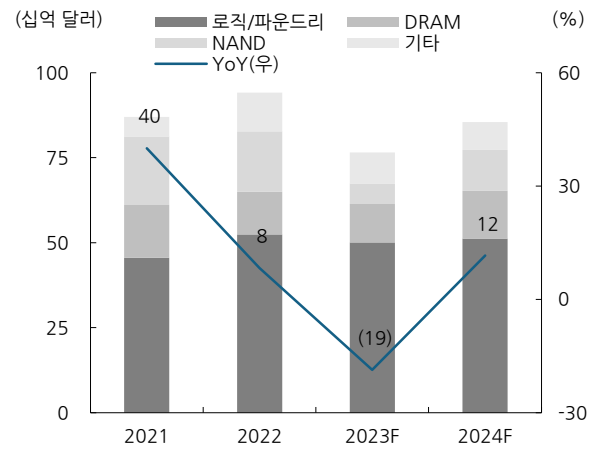
자료: 각 사, DS투자증권 리서치센터

그림10 장비별 메모리 반도체향 CAPEX 규모 전망



자료: SEMI, DS투자증권 리서치센터

그림11 응용처별 Wafer FAB 장비 CAPEX



자료: SEMI, DS투자증권 리서치센터

Valuation

글로벌 독점 기술력과 2024년 포트폴리오 확장 모멘텀

HPSP의 2024년 매출액 2,164억원(+21% YoY), 영업이익 1,182억원(+20% YoY, OPM 55%)을 전망한다. 2022~2023년 글로벌 반도체 업황 다운사이클의 영향으로 동사 역시 장비 납품 지연, 신장비 납품 일정 연기 등 영향이 있었으나 글로벌 독점 기술력과 선단공정에 대한 고객사 투자 기조 유지로 매출액 성장 및 50% 이상의 높은 영업이익률을 유지할 것으로 전망한다. 2024년 역시 불확실한 대외 환경에도 불구하고 메모리 고객사들의 선별적인 Capex 증가(1a, 1b 전환 및 HBM Capa 증설)로 인해 동사 장비 수요는 증가할 것이다.

목표주가는 신공장 Capa가 온기로 반영되는 2025년 추정 EPS 1,812원에 Target P/E 32배를 적용한 58,000원으로 제시한다. Target P/E는 글로벌 장비업체(AMAT, Lam Research, TEL, ASML)의 12M Fwd P/E 평균으로 산출했다.

표1 HPSP 실적 추정 Table

	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23F	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2023F	2024F	2025F
매출액	588	479	419	301	390	447	710	617	1,787	2,164	3,275
QoQ/YoY %	33.9	-18.5	-12.4	-28.2	29.6	14.7	58.7	-13.1	12.2	21.1	51.3
고압수소 어닐링 장비	553	437	407	291	355	413	680	592	1,688	2,041	3,003
비메모리(로직/파운드리)	404	319	323	231	235	271	487	439	1,277	1,432	2,102
메모리	149	118	84	60	119	143	193	154	411	609	901
고압습식 산화막 장비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87
부품/AS	35	42	12	10	35	34	30	25	99	123	185
영업이익	350	266	216	151	222	251	407	302	982	1,182	1,798
OPM (%)	59.4	55.5	51.5	50.0	56.9	56.2	57.3	49.0	54.9	54.6	54.9
매출비중 (%)											
고압수소 어닐링 장비	94.0	91.2	97.0	96.7	91.0	92.5	95.8	96.0	94.4	94.3	91.7
고압습식 산화막 장비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
부품/AS	6.0	8.8	3.0	3.3	9.0	7.5	4.2	4.0	5.6	5.7	5.6

자료: HPSP, DS투자증권 리서치센터

표2 HPSP 목표주가 산정

구분	내용	비고
추정 EPS (원)	1,812	2025F 추정 EPS
Target Multiple (배)	32.0	글로벌 장비업체 (AMAT, Lam Research, TEL, ASML 12M Fwd P/E)
주당기업가치 (원)	57,969	
목표주가 (원)	58,000	
현재주가 (원)	46,600	2024.01.30 종가
상승여력	24%	

자료: DS투자증권 리서치센터

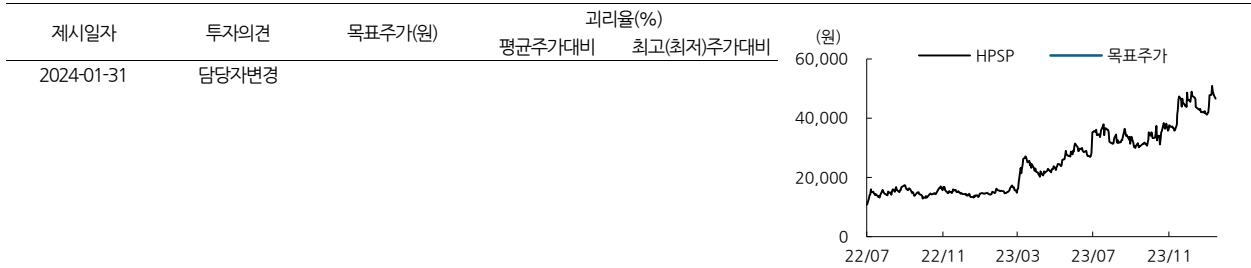
[HPSP 403870]

재무상태표						손익계산서					
	2021	2022	2023F	2024F	2025F		2021	2022	2023F	2024F	2025F
유동자산	869	2,450	2,902	3,866	5,268	매출액	918	1,593	1,787	2,164	3,300
현금 및 현금성자산	542	1,300	598	1,201	2,193	매출원가	301	492	592	685	1,033
매출채권 및 기타채권	65	34	75	154	246	매출총이익	616	1,101	1,195	1,479	2,267
재고자산	175	339	191	391	623	판매비 및 관리비	164	249	213	297	470
기타	86	777	2,038	2,120	2,206	영업이익	452	852	981	1,182	1,798
비유동자산	47	159	305	393	527	(EBITDA)	461	863	1,005	1,245	1,881
관계기업투자등	0	0	0	0	0	금융손익	15	16	130	18	19
유형자산	10	101	258	327	444	이자비용	2	2	2	2	2
무형자산	3	3	17	35	51	관계기업등 투자손익	0	0	0	0	0
자산총계	916	2,609	3,207	4,259	5,796	기타영업외손익	0	1	0	97	98
유동부채	363	634	412	498	597	세전계속사업이익	467	869	1,112	1,297	1,914
매입채무 및 기타채무	146	211	69	142	227	계속사업법인세비용	113	209	253	301	444
단기금융부채	7	10	10	10	10	계속사업이익	353	660	859	996	1,470
기타유동부채	211	413	333	346	360	중단사업이익	0	0	0	0	0
비유동부채	26	21	16	16	16	당기순이익	353	660	859	996	1,470
장기금융부채	18	21	16	16	16	지배주주	353	660	859	996	1,470
기타비유동부채	8	0	1	1	1	총포괄이익	353	660	859	996	1,470
부채총계	389	656	428	514	613	매출총이익률 (%)	67.2	69.1	66.9	68.4	68.7
지배주주지분	527	1,954	2,779	3,745	5,183	영업이익률 (%)	49.3	53.5	54.9	54.6	54.5
자본금	84	101	406	406	406	EBITDA마진률 (%)	50.3	54.1	56.2	57.5	57.0
자본잉여금	84	841	534	534	534	당기순이익률 (%)	38.5	41.4	48.1	46.0	44.5
이익잉여금	297	960	1,801	2,767	4,205	ROA (%)	50.1	37.4	29.5	26.7	29.2
비지배주주지분(연결)	0	0	0	0	0	ROE (%)	81.4	53.2	36.3	30.5	32.9
자본총계	527	1,954	2,779	3,745	5,183	ROIC (%)	n/a	2,756.3	492.3	219.8	187.2

현금흐름표						주요투자지표					
	2021	2022	2023F	2024F	2025F		2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동 현금흐름	378	821	766	862	1,324	투자지표 (x)					
당기순이익(손실)	353	660	859	996	1,470	P/E	n/a	16.4	44.0	38.0	25.7
비현금수익비용가감	161	336	164	63	84	P/B	n/a	1.4	13.6	10.1	7.3
유형자산감가상각비	8	11	23	59	78	P/S	n/a	6.8	21.2	17.5	11.5
무형자산상각비	1	0	1	3	5	EV/EBITDA	-1.1	10.4	35.9	28.4	18.3
기타현금수익비용	151	325	26	0	0	P/CF	n/a	10.9	37.0	35.7	24.3
영업활동 자산부채변동	-59	-36	-65	-197	-230	배당수익률 (%)	n/a	0.3	0.1	0.1	0.1
매출채권 감소(증가)	-56	22	-9	-79	-92	성장성 (%)					
재고자산 감소(증가)	-91	-164	137	-200	-232	매출액	50.0	73.7	12.2	21.1	52.5
매입채무 증가(감소)	37	54	-117	73	85	영업이익	61.3	88.4	15.2	20.5	52.0
기타자산 부채변동	51	52	-75	9	10	세전이익	73.9	86.2	27.9	16.7	47.6
투자활동 현금	-3	-786	-1,412	-229	-300	당기순이익	68.9	86.8	30.1	16.0	47.6
유형자산처분(취득)	-2	-94	-154	-128	-195	EPS	67.5	53.8	30.1	16.0	47.6
무형자산 감소(증가)	0	0	-15	-22	-22	안정성 (%)					
투자자산 감소(증가)	0	-696	-1,243	-79	-82	부채비율	73.7	33.6	15.4	13.7	11.8
기타투자활동	0	4	0	-1	-1	유동비율	239.3	386.4	704.5	776.0	882.7
재무활동 현금	-202	723	-66	-30	-32	순차입금/자기자본(x)	-98.2	-98.1	-90.3	-85.2	-82.3
차입금의 증가(감소)	-4	-7	-8	0	0	영업이익/금융비용(x)	261.6	485.6	568.9	745.9	1,134.2
자본의 증가(감소)	-198	730	-56	-30	-32	총차입금 (십억원)	24	30	25	25	25
배당금의 지급	200	0	18	30	32	순차입금 (십억원)	-518	-1,916	-2,508	-3,190	-4,263
기타재무활동	0	0	-2	0	0	주당지표(원)					
현금의 증가	178	758	-702	602	992	EPS	529	813	1,058	1,228	1,812
기초현금	364	542	1,300	598	1,201	BPS	3,157	9,629	3,424	4,614	6,386
기말현금	542	1,300	598	1,201	2,193	SPS	1,373	1,963	2,202	2,666	4,066
NOPLAT	342	647	758	908	1,380	CFPS	769	1,227	1,261	1,305	1,915
FCF	453	174	-453	633	1,025	DPS	n/a	38	40	40	40

자료: HPSP, DS투자증권 리서치센터 / 주: K-IFRS 연결기준

HPSP (403870) 투자의견 및 목표주가 변동추이



투자의견 및 적용기준 (향후 12개월간 주가 등락 기준)

기업		산업	
매수	+ 10% 이상의 투자수익이 예상되는 경우	비중확대	업종별 투자의견은 해당업종 투자비중에 대한 의견
중립	- 10% ~ + 10% 이내의 등락이 예상되는 경우	중립	
매도	- 10% 이하의 주가하락이 예상되는 경우	비중축소	

투자의견 비율

기준일 2023.12.31

매수	중립	매도
98.0%	2.0%	0.0%

Compliance Notice

본 자료에 기재된 내용들은 작성자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 자료는 고객의 증권투자를 돕기 위한 정보제공을 목적으로 제작되었습니다. 본 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나, 당사가 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 참고자료로만 활용하시기 바라며 유가증권 투자 시 투자자 자신의 판단과 책임하에 최종결정을 하시기 바랍니다. 따라서 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.

- 동 자료는 제공시점 현재 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사에서 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목은 전일 기준 현재 당사의 조사분석 담당자 및 그 배우자 등 관련자가 보유하고 있지 않습니다.
- 동 자료의 추천종목에 해당하는 회사는 당사와 계열회사 관계에 있지 않습니다.